

01.12.2004

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

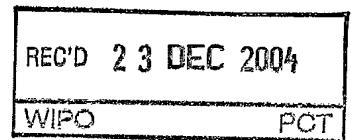
別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2003年12月 9日

出願番号 Application Number: 特願2003-410105

[ST. 10/C]: [JP2003-410105]



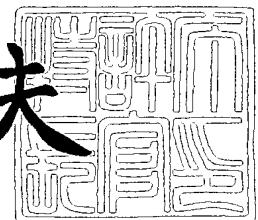
出願人 Applicant(s): 東京エレクトロン株式会社

PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 5月20日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今井康夫



**【書類名】** 特許願  
**【整理番号】** TKL03024  
**【提出日】** 平成15年12月 9日  
**【あて先】** 特許庁長官 今井 康夫 殿  
**【国際特許分類】** H01L 21/00  
**【発明者】**  
 【住所又は居所】 東京都港区赤坂五丁目3番6号 TBS放送センター 東京エレクトロン株式会社内  
**【氏名】** 篠塚 真一  
**【発明者】**  
 【住所又は居所】 東京都港区赤坂五丁目3番6号 TBS放送センター 東京エレクトロン株式会社内  
**【氏名】** 和田 栄希  
**【発明者】**  
 【住所又は居所】 東京都港区赤坂五丁目3番6号 TBS放送センター 東京エレクトロン株式会社内  
**【氏名】** 山下 剛秀  
**【特許出願人】**  
**【識別番号】** 000219967  
**【氏名又は名称】** 東京エレクトロン株式会社  
**【代理人】**  
**【識別番号】** 100096389  
**【弁理士】**  
**【氏名又は名称】** 金本 哲男  
**【電話番号】** 03-3226-6631  
**【選任した代理人】**  
**【識別番号】** 100095957  
**【弁理士】**  
**【氏名又は名称】** 亀谷 美明  
**【電話番号】** 03-5919-3808  
**【選任した代理人】**  
**【識別番号】** 100101557  
**【弁理士】**  
**【氏名又は名称】** 萩原 康司  
**【電話番号】** 03-3226-6631  
**【手数料の表示】**  
**【予納台帳番号】** 040235  
**【納付金額】** 21,000円  
**【提出物件の目録】**  
**【物件名】** 特許請求の範囲 1  
**【物件名】** 明細書 1  
**【物件名】** 図面 1  
**【物件名】** 要約書 1  
**【包括委任状番号】** 9602173

**【書類名】特許請求の範囲****【請求項 1】**

基板を搬入出する搬入出部と、基板の処理を行う処理部と、基板の検査を行う検査部を有し、これらの部の間で基板を搬送できるように構成された基板処理装置を制御する方法であって、

前記搬入出部に搬入された基板を前記処理部に搬送して処理する基板の処理フローと、前記搬入出部に搬入された基板を前記検査部に搬送して検査する基板の検査フローとを独立に実行することを特徴とする、基板処理装置の制御方法。

**【請求項 2】**

前記基板の処理フローの終了した基板を前記搬入出部に戻し、前記検査部で他の基板の検査が行われていないときに、前記搬入出部の基板に対して前記基板の検査フローを実行することを特徴とする、請求項 1 に記載の基板処理装置の制御方法。

**【請求項 3】**

前記基板の処理フローの終了した基板に対する検査が前記検査部で行われていないときに、基板処理装置の外部から前記搬入出部に搬入された外部の基板に対して前記基板の検査フローを実行することを特徴とする、請求項 1 又は 2 のいずれかに記載の基板処理装置の制御方法。

**【請求項 4】**

前記基板の処理フローと前記基板の検査フローを、基板のロット単位で実行し、

前記基板の処理フローの終了したロットに対して前記基板の検査フローを実行し、

当該ロットに対する前記基板の検査フローの実行期間と重ならないように、基板処理装置の外部から前記搬入出部に搬入された外部のロットに対して前記基板の検査フローを実行することを特徴とする、請求項 1 又は 2 のいずれかに記載の基板処理装置の制御方法。

**【請求項 5】**

前記基板の処理フローの終了した前記ロットに対する前記基板の検査フローを、前記外部のロットに対する前記基板の検査フローよりも優先させることを特徴とする、請求項 4 に記載の基板処理装置の制御方法。

**【請求項 6】**

前記外部のロットに対する前記基板の検査フローを、前記基板の処理フローの終了した前記ロットに対する前記基板の検査フローよりも優先させることを特徴とする、請求項 4 に記載の基板処理装置の制御方法。

**【請求項 7】**

前記検査部に設けられた複数の検査ユニットから所定の検査ユニットを選択して、当該選択された検査ユニットにおける前記基板の検査フローを基板に対して実行することを特徴とする、請求項 1, 2, 3, 4, 5 又は 6 のいずれかに記載の基板処理装置の制御方法。

**【請求項 8】**

基板を搬入出する搬入出部と、基板の処理を行う処理部と、基板の検査を行う検査部と有し、これらの部の間で基板を搬送できるように構成された基板処理装置であって、

前記搬入出部に搬入された基板を前記処理部に搬送して処理する基板の処理フローと、前記搬入出部に搬入された基板を前記検査部に搬送して検査する基板の検査フローとを独立に実行可能な制御部を有することを特徴とする、基板処理装置。

**【請求項 9】**

前記制御部は、前記基板の処理フローの終了した基板を前記搬入出部に戻し、前記検査部で他の基板の検査が行われていないときに、前記搬入出部の基板に対して前記基板の検査フローを実行できることを特徴とする、請求項 8 に記載の基板処理装置。

**【請求項 10】**

前記制御部は、前記基板の処理フローの終了した基板の検査が前記検査部で行われていないときに、基板処理装置の外部から前記搬入出部に搬入された外部の基板に対して前記基板の検査フローを実行できることを特徴とする、請求項 8 又は 9 のいずれかに記載の基板処理装置。

**【請求項11】**

前記制御部は、前記基板の処理フローと前記基板の検査フローを、基板のロット単位で実行でき、さらに、前記基板の処理フローの終了したロットに対して前記基板の検査フローの実行でき、当該ロットに対する前記基板の検査フローの実行期間と重ならないように、基板処理装置の外部から前記搬入出部に搬入された外部のロットに対して前記基板の検査フローを実行できることを特徴とする、請求項8又は9のいずれかに記載の基板処理装置。

**【請求項12】**

前記制御部は、前記基板の処理フローの終了した前記ロットに対する前記基板の検査フローを、前記外部のロットに対する前記基板の検査フローよりも優先させることができることを特徴とする、請求項11に記載の基板処理装置。

**【請求項13】**

前記制御部は、前記外部のロットに対する前記基板の検査フローを、前記基板の処理フローの終了した前記ロットに対する前記基板の検査フローよりも優先させることができることを特徴とする、請求項11に記載の基板処理装置。

**【請求項14】**

前記制御部は、前記基板の処理フローの終了した前記ロットに対する基板の検査フローと前記外部のロットに対する基板の検査フローとのいずれを優先させるかを切り換えることができることを特徴とする、請求項11、12又は13のいずれかに記載の基板処理装置。

**【請求項15】**

前記検査部には、複数の検査ユニットが設けられ、

前記制御部は、前記複数の検査ユニットから所定の検査ユニットを選択して、当該選択された検査ユニットにおける前記基板の検査フローを基板に対して実行できることを特徴とする、請求項8、9、10、11、12、13又は14のいずれかに記載の基板処理装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】基板処理装置の制御方法及び基板処理装置

【技術分野】

【0001】

本発明は、基板処理装置の制御方法及び基板処理装置に関する。

【背景技術】

【0002】

例えば半導体デバイスの製造プロセスにおける基板のフォトリソグラフィー工程は、通常、塗布現像処理装置を用いて行われている。塗布現像処理装置は、本体内に、基板を搬入出するローダ・アンローダ部と、レジスト塗布処理、現像処理、熱処理等の一連の複数の処理が行われる処理部と、当該装置に隣接して設けられた露光装置に対して基板の受け渡しを行うインターフェイス部を備え、これらの各部には、各部内又は隣接する部間で基板を搬送する搬送ユニットが備えられている。

【0003】

また、近年では、塗布現像処理装置内に処理後の基板の膜厚、線幅等を検査する検査部を備えているものが提案されている（例えば、特許文献1参照。）。この塗布現像処理装置によれば、処理後の基板を直ちに検査し、基板処理の不具合等を早期に検出することができる。

【0004】

従来より、塗布現像処理装置で実行される基板処理のフローは、例えば塗布現像処理装置内の制御部で実行されている。上述の検査部のない従来の塗布現像処理装置の制御部には、ローダ・アンローダ部から搬入された基板を処理部に搬送して処理し、処理の終了した基板をローダ・アンローダ部に戻すようなフローが設定されていた。上述の検査部を備えた塗布現像処理装置の制御部には、従来のフローに検査部における検査フローを組み込んだもの、つまり、ローダ・アンローダ部から搬入された基板を処理部に搬送して処理し、処理の終了した基板の中から選択された基板を検査部において検査し、その後、総ての基板をローダ・アンローダ部に戻すように設定されていた。このため、当該塗布現像処理装置で処理される基板は、ローダ・アンローダ部に搬入されると、必ず処理部に搬送されて処理され、その後選択的に検査部で検査されていた。

【0005】

ところで、塗布現像処理装置の立ち上げ時には、処理部における各処理ユニットの各種設定等を調整する調整作業や、検査部の精度等を評価する評価作業を行う必要がある。この処理部の調整作業や検査部の評価作業は、外的要因を排除するためそれぞれ単独で行う必要がある。しかしながら、上述の検査部を備えた塗布現像処理装置においては、基板処理のフローを実行すると、必ず処理部を通過し基板に外乱が加わるため、フローの実行によって検査部の評価作業を行うことはできなかった。このため、検査部の評価作業をする場合、前記検査部に対し基板を直接搬入出する機構を備えた専用の評価ユニットを検査部に別途隣接させ、当該評価ユニットから検査部に対して基板を搬入出すことによって行われていた。それ故、塗布現像処理装置の立ち上げ作業には、専用の評価ユニットが必要であり、例えば基板の製造メーカーにとっては、評価ユニットの購入や維持などにかかるコストが負担になり、装置メーカー及び検査器メーカーにとっては、評価ユニットの開発コストや開発労力が負担になっていた。

【0006】

また、専用の評価ユニットを用いて検査部の評価作業を行っている際には、当然、実際に基板を流して行われる処理部の調整作業は行うことができない。このように、検査部の評価作業と処理部の調整作業とを同時期に行うことができず、塗布現像処理装置の立ち上げに、多大な時間を要していた。

【0007】

さらに、塗布現像処理装置で基板処理が行われている時には、所定枚数に一枚の割合で基板の検査が行われることが多く、検査部が空の状態になっている場合が多い。そのため

、検査部の稼働率を向上し、検査部を効率的に利用することが望まれている。

#### 【0008】

【特許文献1】特開2000-223401号公報

#### 【発明の開示】

#### 【発明が解決しようとする課題】

#### 【0009】

本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、検査部を備えた塗布現像処理装置などの基板処理装置において、装置立ち上げのために要する時間を短縮し、コストを低減し、さらに検査部の稼働率を向上できる基板処理装置の制御方法及び基板処理装置を提供することをその目的とする。

#### 【課題を解決するための手段】

#### 【0010】

上記目的を達成するために、本発明は、基板を搬入出する搬入出部と、基板の処理を行う処理部と、基板の検査を行う検査部を有し、これらの部の間で基板を搬送できるように構成された基板処理装置を制御する方法であって、前記搬入出部に搬入された基板を前記処理部に搬送して処理する基板の処理フローと、前記搬入出部に搬入された基板を前記検査部に搬送して検査する基板の検査フローとを独立に実行することを特徴とする。

#### 【0011】

本発明によれば、基板の処理フローと検査フローを独立に実行するので、例えば基板処理装置の立ち上げ時に、基板の検査フローを実行し、搬入出部に搬入された例えば評価用の基板を直接検査部に送って検査を実行することができる。この検査の結果に基づいて検査部の評価を行うことができるので、従来の専用の評価ユニットが必要なくなり、この評価ユニットに関する費用を削減できる。また、基板の検査フローと処理フローを同時にを行い、検査部の評価作業と処理部の調整作業を同時進行で行うことができるので、基板処理装置の立ち上げにかかる時間を短縮できる。また、基板処理装置の検査部のみを単独で使用できるので、空いている検査部を活用して検査部の稼働率を向上させることができる。

#### 【0012】

前記基板の処理フローの終了した基板を前記搬入出部に戻し、前記検査部で他の基板の検査が行われていないときに、前記基板に対して前記基板の検査フローを実行するようにしてもよい。かかる場合、基板の処理フローが終了した基板が搬入出部に戻されるので、例えば検査部などに基板を待機させておくためのバッファ等を設ける必要がない。この結果、検査部のフットプリントを低減でき、装置全体の小型化が図られる。

#### 【0013】

前記基板の処理フローの終了した基板の検査が前記検査部で行われていないときに、基板処理装置の外部から前記搬入出部に搬入された外部の基板に対して前記基板の検査フローを実行するようにしてもよい。この外部の基板は、検査目的のためだけに基板処理装置の搬入出部に搬入されたものであって、例えば他の処理装置で既に処理が施されているものである。かかる場合、例えば他の処理装置で処理された基板の検査を行うことができるので、例えば基板製造が行われる工場全体の検査ユニットの台数を減らしてコストの削減を図ることができる。また、検査部の稼働率が上げて、工場全体の処理効率を向上することができる。

#### 【0014】

前記基板の処理フローと前記基板の検査フローを、基板のロット単位で実行し、前記基板の処理フローの終了したロットに対して前記基板の検査フローの実行し、当該ロットに対する前記基板の検査フローの実行期間と重ならないように、基板処理装置の外部から前記搬入出部に搬入された外部のロットに対して前記基板の検査フローを実行するようにしてもよい。また、前記基板の処理フローの終了した前記ロットに対する前記基板の検査フローを、前記外部のロットに対する前記基板の検査フローよりも優先させてよい。かかる場合、この基板処理装置で処理されたロットの検査を優先するので、基板処理装置内の基板の流れが滞ることがなく、外部からのロットを検査する場合であっても基板処理装置

の処理効率を維持できる。なお、前記外部のロットに対する前記基板の検査フローを、前記基板の処理フローの終了した前記ロットに対する前記基板の検査フローよりも優先させようとしてもよい。

#### 【0015】

前記検査部に設けられた複数の検査ユニットから所定の検査ユニットを選択して、当該選択された検査ユニットにおける前記基板の検査フローを基板に対して実行するようにしてもよい。かかる場合、例えば基板毎或いはロット毎に必要な検査を自由に選択して行うことができる。

#### 【0016】

本発明は、基板を搬入出する搬入出部と、基板の処理を行う処理部と、基板の検査を行う検査部と有し、これらの部の間で基板を搬送できるように構成された基板処理装置であって、前記搬入出部に搬入された基板を前記処理部に搬送して処理する基板の処理フローと、前記搬入出部に搬入された基板を前記検査部に搬送して検査する基板の検査フローとを独立に実行可能な制御部を有することを特徴とする。

#### 【0017】

本発明によれば、基板の処理フローと検査フローを独立に実行できるので、例えば基板処理装置の立ち上げ時に、基板の検査フローを実行し、搬入出部に搬入された例えは評価用の基板を直接検査部に送って検査を実行することができる。この検査の結果に基づいて検査部の評価を行うことができるので、従来の専用の評価ユニットが必要なくなり、この評価ユニットに関する費用を削減できる。また、基板の検査フローと処理フローを同時に実行し、検査部の評価作業と処理部の調整作業を同時進行で行うことができるので、基板処理装置の立ち上げにかかる時間を短縮できる。また、基板処理装置の検査部のみを単独で使用できるので、空いている検査部を活用して検査部の稼働率を向上させることができる。

#### 【0018】

前記制御部は、前記基板の処理フローの終了した基板を前記搬入出部に戻し、前記検査部で他の基板の検査が行われていないときに、前記搬入出部の基板に対して前記基板の検査フローを実行できるようにしてもよい。かかる場合、基板の処理フローが終了した基板が搬入出部に戻されるので、例えは検査部などに基板を待機させておくためのバッファ等を設ける必要がなく、検査部のフットプリントを低減し装置全体の小型化が図られる。

#### 【0019】

前記制御部は、前記基板の処理フローの終了した基板の検査が前記検査部で行われていないときに、基板処理装置の外部から前記搬入出部に搬入された外部の基板に対して前記基板の検査フローを実行できてもよい。かかる場合、外部の基板に対して基板の検査フローを実行することによって、検査部の稼働率を向上することができる。

#### 【0020】

前記制御部は、前記基板の処理フローと前記基板の検査フローを、基板のロット単位で実行でき、前記基板の処理フローの終了したロットに対して前記基板の検査フローを実行でき、当該ロットに対する前記基板の検査フローの実行期間と重ならないように、基板処理装置の外部から前記搬入出部に搬入された外部のロットに対して前記基板の検査フローを実行できることによってもよい。また、前記制御部は、前記基板の処理フローの終了した前記ロットに対する前記基板の検査フローを、前記外部のロットに対する前記基板の検査フローよりも優先させることができてもよい。かかる場合、この基板処理装置内で処理された基板の検査が優先されるので、基板処理装置内の基板の流れが滞ることなく、たとえ外部の基板を検査しても、この基板処理装置の処理効率を維持できる。

#### 【0021】

前記制御部は、前記外部のロットに対する前記基板の検査フローを、前記基板の処理フローの終了した前記ロットに対する前記基板の検査フローよりも優先させることができてもよい。また、前記制御部は、前記基板の処理フローの終了した前記ロットに対する前記基板の検査フローと前記外部のロットに対する基板の検査フローとのいずれを優先させる

かを切り換えることができてもよい。

#### 【0022】

前記検査部には、複数の検査ユニットが設けられ、前記制御部は、前記複数の検査ユニットから所定の検査ユニットを選択して、当該選択された検査ユニットにおける前記基板の検査フローを基板に対して実行できるものであってもよい。かかる場合、例えば基板毎或いはロット毎に必要な検査を自由に選択して行うことができる。

#### 【発明の効果】

#### 【0023】

本発明によれば、検査部を備えた基板処理装置において、立ち上げ作業にかかる時間を短縮し、費用を低減し、さらに検査部の稼働率を向上させることができる。

#### 【発明を実施するための最良の形態】

#### 【0024】

以下、本発明の好ましい実施の形態について説明する。図1は、基板としてのウェハのフォトリソグラフィー工程が行われる塗布現像処理装置1の構成の概略を示す平面図であり、図2は、塗布現像処理装置1の正面図であり、図3は、塗布現像処理装置1の背面図である。

#### 【0025】

塗布現像処理装置1は、図1に示すように例えば25枚のウェハWをカセット単位で外部から塗布現像処理装置1に対して搬入出したり、カセットCに対してウェハWを搬入出したりする搬入出部としてのカセットステーション2と、ウェハWを検査する検査部としての検査ステーション3と、塗布現像工程の中で枚葉式に所定の処理を施す各種処理ユニットを多段配置してなる処理部としての処理ステーション4と、この処理ステーション4に隣接して設けられている図示しない露光装置との間でウェハWの受け渡しをするインターフェイス部5とを一体に接続した構成を有している。

#### 【0026】

カセットステーション2では、カセット載置台6上の所定の位置に、複数、例えば5つのカセットCをX方向（図1中の上下方向）に沿って一列に載置できる。カセットステーション2には、搬送路7上をX方向に向かって移動可能なウェハ搬送体8が設けられている。ウェハ搬送体8は、上下方向にも移動可能であり、カセットC内に上下方向に配列されたウェハWに対して選択的にアクセスできる。ウェハ搬送体8は、鉛直方向の軸周りのθ方向に回転可能であり、後述する検査ステーション3側の受け渡し部10に対してもアクセスできる。

#### 【0027】

カセットステーション2に隣接する検査ステーション3は、例えば複数の検査ユニットが多段に配置された検査ユニット群Kを備えている。検査ステーション3は、カセットステーション2との間でウェハWを受け渡しするための受け渡し部10を備えている。この受け渡し部10には、例えばウェハWを載置する載置部10aが設けられている。検査ステーション3には、例えばX方向に延伸する搬送路11上を移動するウェハ搬送装置12が設けられている。ウェハ搬送装置12は、例えば上下方向に移動可能かつθ方向にも回転自在であり、検査ユニット群K内の後述する各検査ユニット、受け渡し部10及び処理ステーション4の第3の処理ユニット群G3内の後述する各処理ユニットに対してアクセスできる。

#### 【0028】

検査ユニット群Kには、例えば図2に示すようにウェハW上に形成された膜の厚みやパターンの線幅を測定する膜厚・線幅検査ユニット20、ウェハ表面上のマクロ欠陥を検出するマクロ欠陥検査ユニット21及び露光の重ね合わせのずれを検出する重ね合わせ検査ユニット22が下から順に3段に重ねられている。

#### 【0029】

検査ステーション3に隣接する処理ステーション4は、図1に示すように複数の処理ユニットが多段に配置された、例えば5つの処理ユニット群G1～G5を備えている。処理

ステーション4のX方向負方向（図1中の下方向）側には、検査ステーション3側から第1の処理ユニット群G1、第2の処理ユニット群G2が順に配置されている。処理ステーション4のX方向正方向（図1中の上方向）側には、検査ステーション3側から第3の処理ユニット群G3、第4の処理ユニット群G4及び第5の処理ユニット群G5が順に配置されている。第3の処理ユニット群G3と第4の処理ユニット群G4の間には、第1の搬送ユニット30が設けられている。第1の搬送ユニット30は、第1の処理ユニット群G1、第3の処理ユニット群G3及び第4の処理ユニット群G4に対して選択的にアクセスしてウェハWを搬送できる。第4の処理ユニット群G4と第5の処理ユニット群G5の間には、第2の搬送ユニット31が設けられている。第2の搬送ユニット31は、第2の処理ユニット群G2、第4の処理ユニット群G4及び第5の処理ユニット群G5に対して選択的にアクセスしてウェハWを搬送できる。

#### 【0030】

図2に示すように第1の処理ユニット群G1には、ウェハWに所定の液体を供給して処理を行う液処理ユニット、例えばウェハWにレジスト液を塗布するレジスト塗布ユニット40、41、42、露光処理時の光の反射を防止する反射防止膜を形成するボトムコーティングユニット43、44が下から順に5段に重ねられている。第2の処理ユニット群G2には、液処理ユニット、例えばウェハWを現像する現像処理ユニット50～54が下から順に5段に重ねられている。また、第1の処理ユニット群G1及び第2の処理ユニット群G2の最下段には、各処理ユニット群G1及びG2内の前記液処理ユニットに各種処理液を供給するためのケミカル室60、61がそれぞれ設けられている。

#### 【0031】

例えば図3に示すように第3の処理ユニット群G3には、温調ユニット70、ウェハWの受け渡しを行うためのトランジションユニット71、精度の高い温度管理下でウェハWを加熱処理する高精度温調ユニット72～74及びウェハWを高温で加熱処理する高温度熱処理ユニット75～78が下から順に9段に重ねられている。

#### 【0032】

第4の処理ユニット群G4では、例えば高精度温調ユニット80、レジスト塗布処理後のウェハWを加熱処理するプリベーキングユニット81～84及び現像処理後のウェハWを加熱処理するポストベーキングユニット85～89が下から順に10段に重ねられている。

#### 【0033】

第5の処理ユニット群G5では、ウェハWを熱処理する複数の熱処理ユニット、例えば高精度温調ユニット90～93、露光後のウェハWを加熱処理するポストエクスポートベーキングユニット94～99が下から順に10段に重ねられている。

#### 【0034】

図1に示すように第1の搬送ユニット30のX方向正方向側には、複数の処理ユニットが配置されており、例えば図3に示すようにウェハWを疎水化処理するためのアドヒージョンユニット100、101、ウェハWを加熱する加熱ユニット102、103が下から順に4段に重ねられている。図1に示すように第2の搬送ユニット31のX方向正方向側には、例えばウェハWのエッジ部のみを選択的に露光する周辺露光ユニット104が配置されている。

#### 【0035】

インターフェイス部5には、例えば図1に示すようにX方向に向けて延伸する搬送路110上を移動するウェハ搬送体111と、バッファカセット112が設けられている。ウェハ搬送体111は、Z方向に移動可能でかつθ方向にも回転可能であり、インターフェイス部5に隣接した図示しない露光装置と、バッファカセット112及び第5の処理ユニット群G5に対してアクセスしてウェハWを搬送できる。

#### 【0036】

以上のように構成された塗布現像処理装置1の制御は、例えば図1及び図2に示すようにカセットステーション2の側部に備えられた制御部としてのコントロールユニット12

0によって行われている。コントロールユニット120には、制御プログラムPが記憶されており、コントロールユニット120は、制御プログラムPに従って、塗布現像処理装置1内の処理ユニット、検査ユニットや搬送ユニットの動作を制御して、塗布現像処理装置1におけるウェハ処理のプロセスを制御できる。制御プログラムPは、例えば図4に示すようにカセットステーション2のウェハWを検査ステーション3を通じて処理ステーション4に搬送し、処理ステーション4及び露光装置で処理を実行した後、検査ステーション3を通過してカセットステーション2に戻すウェハWの処理フローF<sub>1</sub>と、カセットステーション2のウェハWを検査ステーション3に搬送し、所定の検査を実行した後、カセットステーション2に戻すウェハWの検査フローF<sub>2</sub>とを独立に実行できるように設定されている。

### 【0037】

次に、以上のように構成された塗布現像処理装置1の作用について説明する。先ず、塗布現像処理装置1の立ち上げ時には、例えばコントロールユニット120によって、制御プログラムPの処理フローF<sub>1</sub>と検査フローF<sub>2</sub>がそれぞれ実行される。例えば評価用のウェハWが収容されたカセットCがカセット載置台6に載置されると、当該評価用のウェハWがウェハ搬送体7によって受け渡し部10に受け渡され、受け渡し部10からウェハ搬送装置12によって各検査ユニット20～22に搬送され、各検査ユニット20～22で検査が終了すると、ウェハ搬送装置12、受け渡し部10及びウェハ搬送体8を介してカセットCに戻される。例えば評価用のウェハWに対する各検査ユニット20～22における測定値を評価することによって検査ユニット20～22の評価作業が行われる。また、例えば処理用のウェハWが収容されたカセットCがカセット載置台6上に載置されると、当該処理用のウェハWがウェハ搬送体8、受け渡し部10及びウェハ搬送装置12を介して処理ステーション4に搬送され、調整の対象となる所定の処理ユニットにおける処理が施された後、再びウェハ搬送装置12、受け渡し部10及びウェハ搬送体8を介してカセットCに戻される。例えばカセットCに戻されたウェハWの処理状態に基づいて各処理ユニットの設定を調整することによって各処理ユニットの調整作業が行われる。

### 【0038】

次に、塗布現像処理装置1の立ち上げ作業が終了し、塗布現像処理装置1において実際にウェハWが処理される際の塗布現像処理装置1の作用について説明する。この実施の形態では、例えば図1に示すようにカセット載置台6上にカセットC<sub>1</sub>、C<sub>2</sub>、C<sub>3</sub>が載置されており、カセットC<sub>1</sub>には、ロットR<sub>1</sub>を構成する複数枚のウェハW<sub>1</sub>が収容され、カセットC<sub>2</sub>には、ロットR<sub>2</sub>を構成する複数枚のウェハW<sub>2</sub>が収容され、カセットC<sub>3</sub>には、ロットR<sub>3</sub>を構成する複数枚のウェハW<sub>3</sub>が収容されている場合を例にとって説明する。図5は、処理フローF<sub>1</sub>と検査フローF<sub>2</sub>の実行タイミングを示す説明図である。

### 【0039】

先ず、塗布現像処理装置1が稼動すると、例えばコントロールユニット120によって制御プログラムPの処理フローF<sub>1</sub>と検査フローF<sub>2</sub>が共に実行可能状態になる。ロットR<sub>1</sub>に対する処理フローF<sub>1</sub>の実行により、カセット載置台6上のカセットC<sub>1</sub>内の複数枚のウェハW<sub>1</sub>が、ウェハ搬送体8によって一枚ずつ順に受け渡し部10に受け渡され、ウェハ搬送装置12によって処理ステーション4の第3の処理ユニット群G<sub>3</sub>に属する温調ユニット70に搬送される。処理ステーション4内において、各ウェハW<sub>1</sub>に対して、温調ユニット70による温調処理、ボトムコーティングユニット43による反射防止膜の形成処理、加熱ユニット102による加熱処理、高温度熱処理ユニット75による高温加熱処理、高精度温調ユニット80による温度調整、レジスト塗布ユニット40によるレジスト塗布処理、プリベーキングユニット81によるプリベーキング処理、周辺露光ユニット104による周辺露光処理及び高精度温調ユニット93による温度調整が順次行われる。その後、各ウェハW<sub>1</sub>は、ウェハ搬送体111によって順次インターフェイス部5を介して露光装置に搬送され、露光処理の終了後再びインターフェイス部5を介して処理ステーション4内に戻される。

### 【0040】

その後、各ウェハW<sub>1</sub>は、ポストエクスピージャーベーキングユニット94による加熱処理、高精度温調ユニット91による温度調節、現像処理ユニット50による現像処理、ポストベーキングユニット85による加熱処理、高精度温調ユニット72による冷却処理が順次行われ、トランジションユニット71からウェハ搬送装置12によって検査ステーション3の受け渡し部10に受け渡される。各ウェハW<sub>1</sub>は、ウェハ搬送体8により受け渡し部10からカセットC<sub>1</sub>に戻される。

#### 【0041】

カセットC<sub>1</sub>のロットR<sub>1</sub>に対する処理フローF<sub>1</sub>が実行され、カセットC<sub>1</sub>内から総てのウェハW<sub>1</sub>が取り出されると、図5に示すように引き続きカセット載置台6上のカセットC<sub>2</sub>のロットR<sub>2</sub>に対する処理フローF<sub>1</sub>が実行され、複数枚の各ウェハW<sub>2</sub>がカセットC<sub>2</sub>から取り出され、各ウェハW<sub>1</sub>と同様の経路を通って処理が施される。さらにカセットC<sub>2</sub>内が空になると、カセットC<sub>3</sub>のロットR<sub>3</sub>に対して処理フローF<sub>1</sub>が実行され、ウェハW<sub>3</sub>も同様の経路を通って処理される。このように各ロットR<sub>1</sub>～R<sub>3</sub>に対して順次処理フローF<sub>1</sub>が実行される。

#### 【0042】

一方、処理フローF<sub>1</sub>を終了したロットR<sub>1</sub>のウェハW<sub>1</sub>がカセットC<sub>1</sub>に戻されると、検査フローF<sub>2</sub>の実行により、ロットR<sub>1</sub>内から選択された数枚のウェハW<sub>1</sub>が、一枚ずつウェハ搬送体8によって検査ステーション3の受け渡し部10に搬送される。このウェハW<sub>1</sub>は、ウェハ搬送装置12によって例えば検査ユニット群Kの膜厚・線幅検査ユニット20、マクロ欠陥検査ユニット21、重ね合わせ検査ユニット22に順に搬入され、各検査ユニットにおいて所定の検査が施される。検査の終了したウェハW<sub>1</sub>は、ウェハ搬送装置12によって受け渡し部10に受け渡され、受け渡し部10からウェハ搬送体8によってカセットC<sub>1</sub>に戻される。また、処理フローF<sub>1</sub>を終了したカセットC<sub>2</sub>、C<sub>3</sub>に戻されたロットR<sub>2</sub>、ロットR<sub>3</sub>に対しても同様に、検査フローF<sub>2</sub>が実行される。

#### 【0043】

次に、検査だけを行う目的で、図1に示すように装置外部からカセット載置台6上にカセットC<sub>4</sub>が載置された場合について説明する。例えばカセットC<sub>4</sub>には、他の処理装置で既に処理の終了したロットR<sub>4</sub>を構成する複数枚のウェハW<sub>4</sub>が収容されている。図6は、かかる場合のフローチャートを示す。例えばロットR<sub>1</sub>に対する処理フローF<sub>1</sub>の実行中に、ロットR<sub>4</sub>のカセットC<sub>4</sub>がカセット載置台6上に載置されると、その時点でロットR<sub>4</sub>に対する検査フローF<sub>2</sub>の実行が開始された場合に、そのロットR<sub>4</sub>の実行期間が、塗布現像処理装置1で処理中のロットR<sub>1</sub>に対する次の検査フローF<sub>2</sub>の実行期間と重なるか否かが、例えばコントロールユニット120において確認される。実行期間が重なる場合、ロットR<sub>1</sub>に対する検査フローF<sub>2</sub>が先に実行され、このときロットR<sub>4</sub>はカセット載置台6上のカセットC<sub>4</sub>内で待機する。そして、図7に示すようにロットR<sub>4</sub>に対する検査フローF<sub>2</sub>は、ロットR<sub>1</sub>に対する検査が終了してから実行される。一方、実行期間が重ならない場合には、直ちにロットR<sub>4</sub>に対する検査フローF<sub>2</sub>が実行される。このように、塗布現像処理装置1内で処理されたロットR<sub>1</sub>の検査フローF<sub>2</sub>は、外部からのロットR<sub>4</sub>よりも優先的に行われる。また、カセットC<sub>4</sub>がカセット載置台6上に載置された時に、ロットR<sub>2</sub>又はロットR<sub>3</sub>の処理フローF<sub>1</sub>が実行中の場合も同様に、検査フローF<sub>2</sub>の実行期間が重なる場合には、次に行われるロットR<sub>2</sub>又はR<sub>3</sub>の検査フローF<sub>2</sub>がロットR<sub>4</sub>よりも優先的に行われ、ロットR<sub>4</sub>に対する検査フローF<sub>2</sub>の実行期間とロットR<sub>2</sub>、R<sub>3</sub>の実行期間とが重ならないように調整される。

#### 【0044】

以上の実施の形態によれば、コントロールユニット120により制御プログラムPの処理フローF<sub>1</sub>と検査フローF<sub>2</sub>とを独立して実行できるので、例えば塗布現像処理装置1の立ち上げ作業時に、検査ステーション3の各検査ユニット20～22の評価作業と、処理ステーション4の各処理ユニットの調整作業とを同時期に行うことができる。それ故、立ち上げ作業の時間が短縮される。また、塗布現像処理装置1のカセットステーション2から直接各検査ユニット20～22にアクセスできるので、従来のように評価作業のため

の専用の評価ユニットが不要であり、当該評価ユニットに関する費用が削減できる。

#### 【0045】

また、塗布現像処理装置1内で処理フローF<sub>1</sub>が実行中であっても、検査ユニット20～22が空いている場合に、外部からのロットR<sub>4</sub>に対して検査フローF<sub>2</sub>を実行できるので、検査ユニット20～22の稼働率を向上することができる。また、塗布現像処理装置1内で処理フローF<sub>1</sub>を行ったロットR<sub>1</sub>～ロットR<sub>3</sub>に対する検査フローF<sub>2</sub>が、外部からのロットR<sub>4</sub>よりも優先的に行われるようにならうようにしたので、外部のロットR<sub>4</sub>の検査を行うようにしても塗布現像処理装置1内のウェハの処理効率を低下させることができない。

#### 【0046】

上記実施の形態では、外部からカセット載置台6に搬入されたロットR<sub>4</sub>に対する検査フローF<sub>2</sub>よりも、塗布現像処理装置1内で処理されたロットR<sub>1</sub>～R<sub>3</sub>の検査フローF<sub>2</sub>を優先的に行っていたが、外部からのロットR<sub>4</sub>に対する検査フローF<sub>2</sub>を優先させててもよい。図8は、かかる場合のフローチャートを示す。例えば外部からのカセットC<sub>4</sub>がカセット載置台6上に載置されると、その時に他のロットに対する検査フローF<sub>2</sub>が実行されているか否かが確認される。検査フローF<sub>2</sub>が実行されている場合には、ロットR<sub>4</sub>は、その実行中の検査フローF<sub>2</sub>が終了するまでカセット載置台6上で待機し、その後ロットR<sub>4</sub>の検査フローF<sub>2</sub>が実行される。カセットC<sub>4</sub>がカセット載置台6上に載置された時に、他のロットの検査フローF<sub>2</sub>が実行されていない場合には、ロットR<sub>4</sub>の検査フローF<sub>2</sub>が直ちに実行される。ロットR<sub>4</sub>に対する検査フローF<sub>2</sub>の実行中に、塗布現像処理装置1内で処理フローF<sub>1</sub>の終了した例えばロットR<sub>1</sub>～R<sub>3</sub>がカセットC<sub>1</sub>～C<sub>3</sub>に戻った場合、ロットR<sub>4</sub>の検査フローF<sub>2</sub>が終了するまでロットR<sub>1</sub>～R<sub>3</sub>はカセット載置台6上で待機する。ロットR<sub>1</sub>～R<sub>3</sub>の検査フローF<sub>2</sub>は、ロットR<sub>4</sub>の検査フローF<sub>2</sub>の終了後に行われる。この例では、例えば所定の事情のあるロットR<sub>4</sub>を、塗布現像処理装置1内のロットよりも優先的に検査することができる。

#### 【0047】

なお、かかる外部のロットR<sub>4</sub>に対する検査フローF<sub>2</sub>を優先するモードと、塗布現像処理装置1内で処理されたロットR<sub>1</sub>～R<sub>3</sub>に対する検査フローF<sub>2</sub>を優先するモードとがコントロールユニット120において切り換え可能になっていてよい。かかる場合、必要に応じて外部のロットR<sub>4</sub>と内部のロットR<sub>1</sub>～R<sub>3</sub>とのいずれかを優先させることができる。

#### 【0048】

以上の実施の形態における処理フローF<sub>1</sub>は、ウェハWをカセットステーション2から処理ステーション4に搬送し、その後処理ステーション4及び露光装置で処理を行った後、直接カセットステーション2に戻すものであったが、処理ステーション4及び露光装置で処理の終了したウェハWを、選択的に検査ステーション3で検査し、その後、カセットステーション2に戻すものであってもよい。かかる場合、例えば処理ステーション4及び露光装置における一連の処理が終了し、ウェハWが検査ステーション3を通る際に、検査ユニット20～22が空いている場合には、ウェハWは検査ユニット20～22で検査を行ってからカセットステーション2に戻され、検査ユニット20～22が空いていない場合には、そのままカセットステーション2に戻される。検査が行われなかったウェハWに対しては、カセットステーション2に戻された後、検査フロー2の実行により検査が行われる。この場合、検査ユニット20～22が空の状態にもかかわらず、ウェハWが検査ステーション3を通過してカセットステーション2に戻されることがなくなるので、検査ユニット20～22の稼働率を向上することができる。

#### 【0049】

上述した検査フローF<sub>2</sub>において、検査ユニット群Kで検査の行われる検査ユニット20～22は、例えば各ロット毎又は各ウェハ毎に任意に選択できてもよい。また、同じ検査ユニット20～22における、検査する位置や検査する範囲などの検査条件も、各ウェハ、各ロット毎に変更できてもよい。

#### 【0050】

以上の実施の形態は、本発明の一例を示すものであり、本発明はこの例に限らず種々の態様を探りうるものである。例えば、上記実施の形態における検査ステーション3における検査ユニットの種類や数は、任意に選択できる。また、上記実施の形態における塗布現像処理装置1では、カセットステーション2と処理ステーション4の間に検査ステーション3が設けられていたが、例えば処理ステーション4とインターフェイス部5との間に検査ステーション3が設けられていてもよい。上記実施の形態では、本発明を塗布現像処理装置1に適用していたが、本発明は、例えば洗浄装置、エッチング装置などの他の基板処理装置にも適用できる。また、上記実施の形態は、ウェハWを処理する塗布現像処理装置であったが、本発明は、ウェハ以外の基板、例えばFPD（フラットパネルディスプレイ）基板、マスク基板、レクチル基板などの他の基板にも適用できる。

#### 【産業上の利用可能性】

##### 【0051】

本発明は、基板の検査部を有する基板処理装置の立ち上げ時間を短縮し、また検査部の稼働率を向上する際に有用である。

#### 【図面の簡単な説明】

##### 【0052】

【図1】本実施の形態における塗布現像処理装置の構成の概略を示す平面図である。

【図2】図1の塗布現像処理装置の正面図である。

【図3】図1の塗布現像処理装置の背面図である。

【図4】塗布現像処理装置に設定される処理フローと検査フローを示す説明図である

。 【図5】処理フローと検査フローの実行タイミングを示す説明図である。

【図6】外部から搬入したロットに対する検査フローを実行する場合のフローチャートである。

【図7】外部から搬入したロットに対する検査フローの実行タイミングを示す説明図である。

【図8】外部から搬入したロットに対する検査フローを実行する場合のフローチャートである。

#### 【符号の説明】

##### 【0053】

1 塗布現像処理装置

2 カセットステーション

3 検査ステーション

4 処理ステーション

20～22 検査ユニット

120 コントロールユニット

F<sub>1</sub> 処理フロー

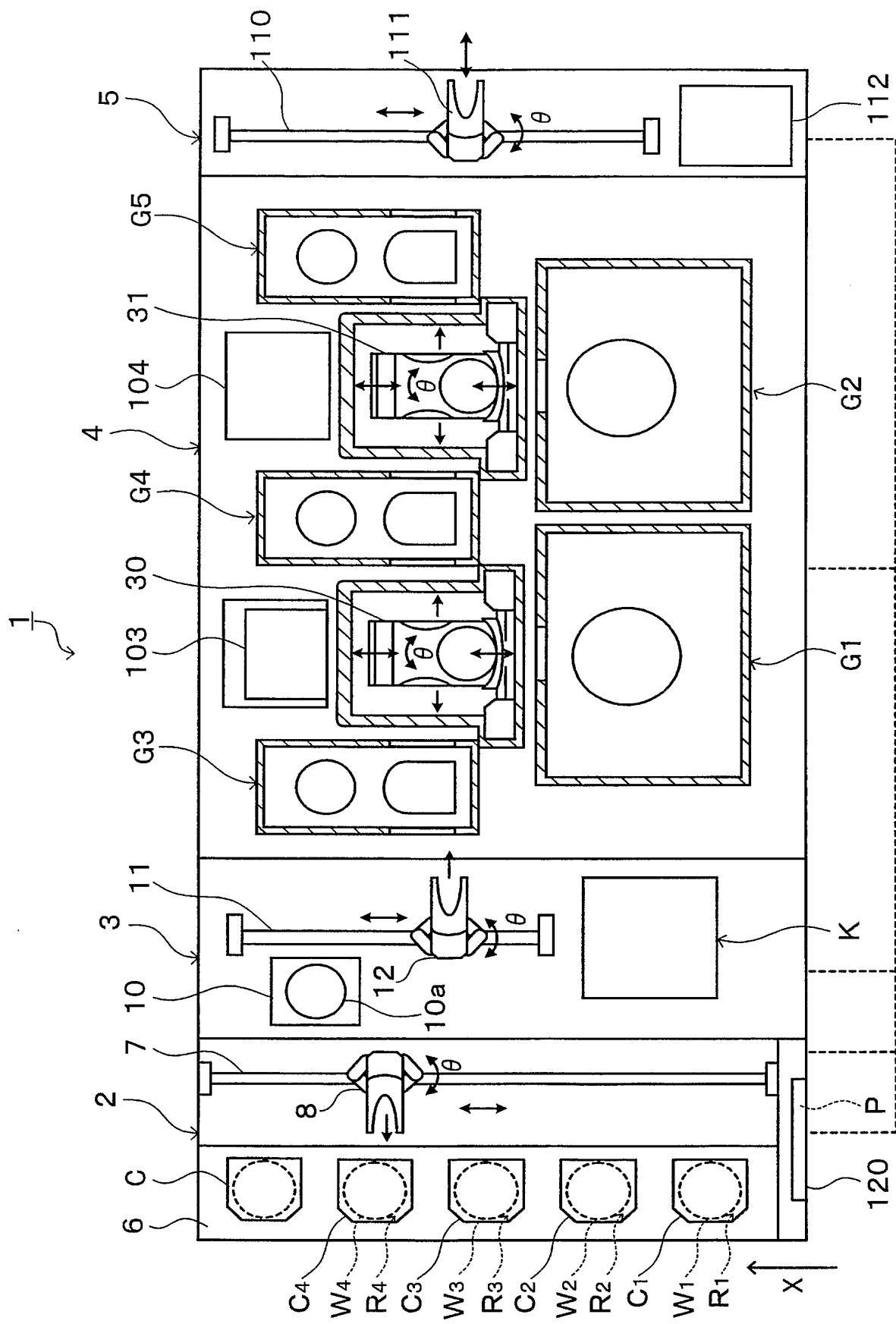
F<sub>2</sub> 検査フロー

C<sub>1</sub>～C<sub>4</sub> カセット

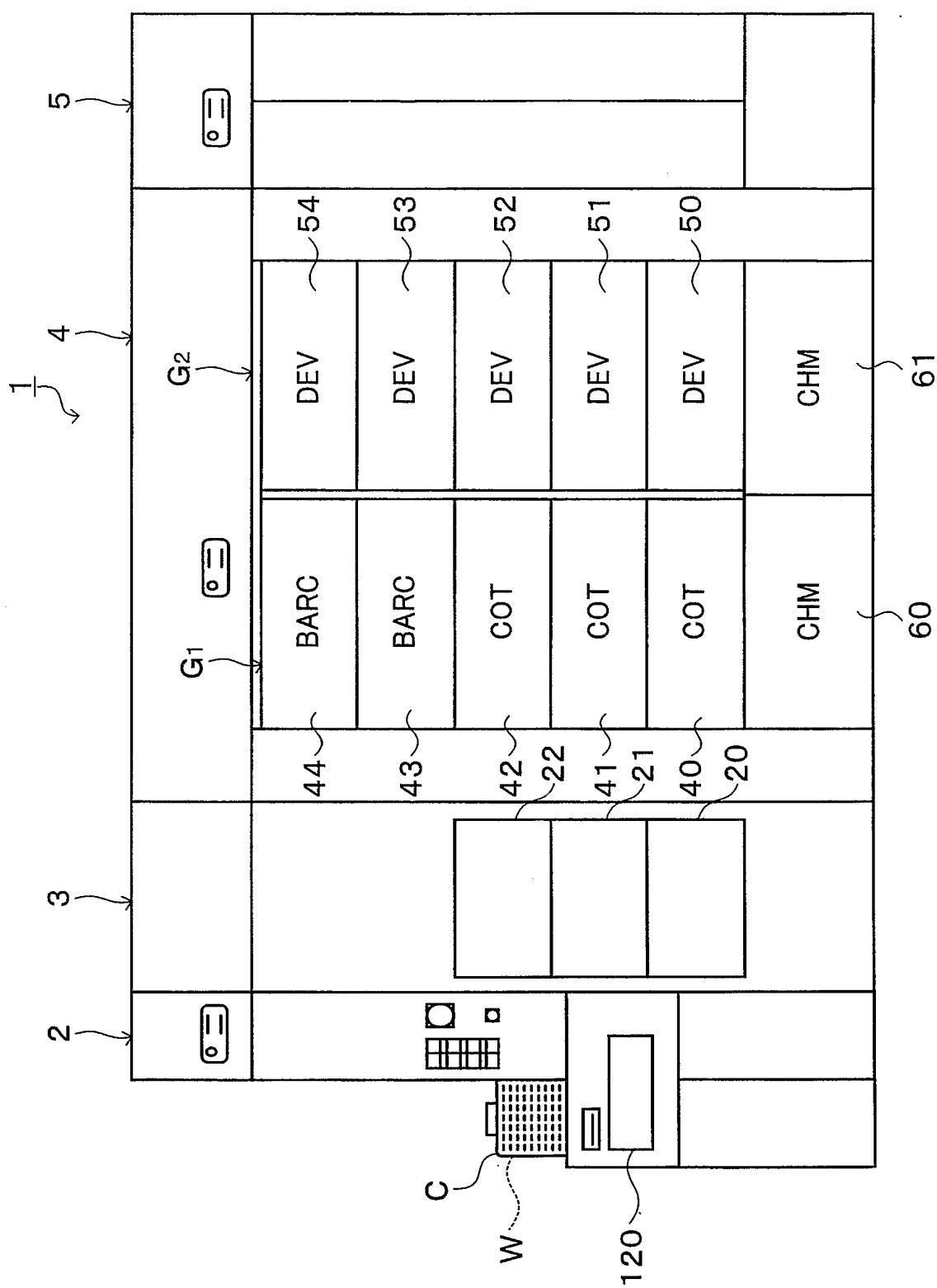
R<sub>1</sub>～R<sub>4</sub> ロット

W<sub>1</sub>～W<sub>4</sub> ウエハ

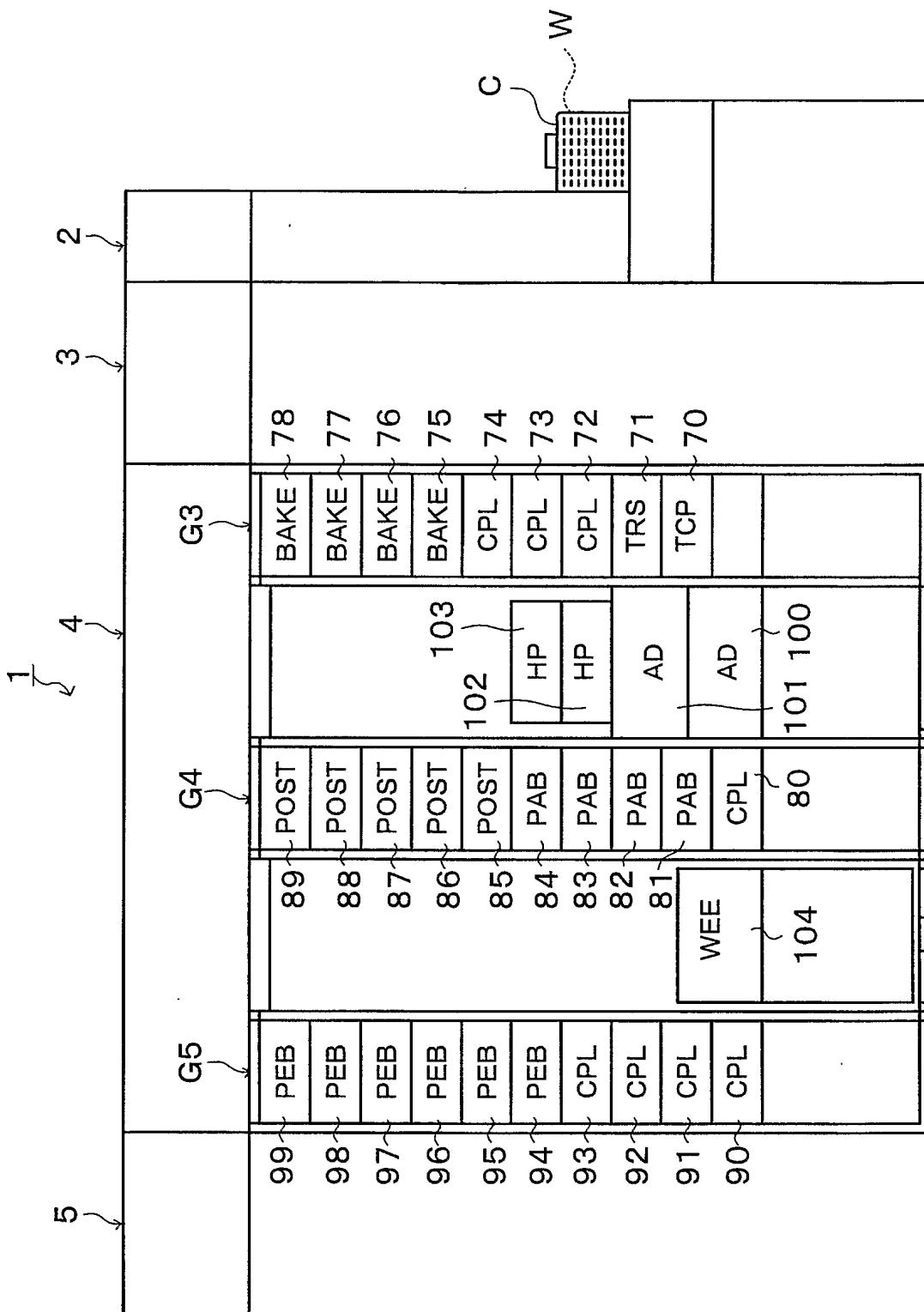
【書類名】 図面  
【図 1】



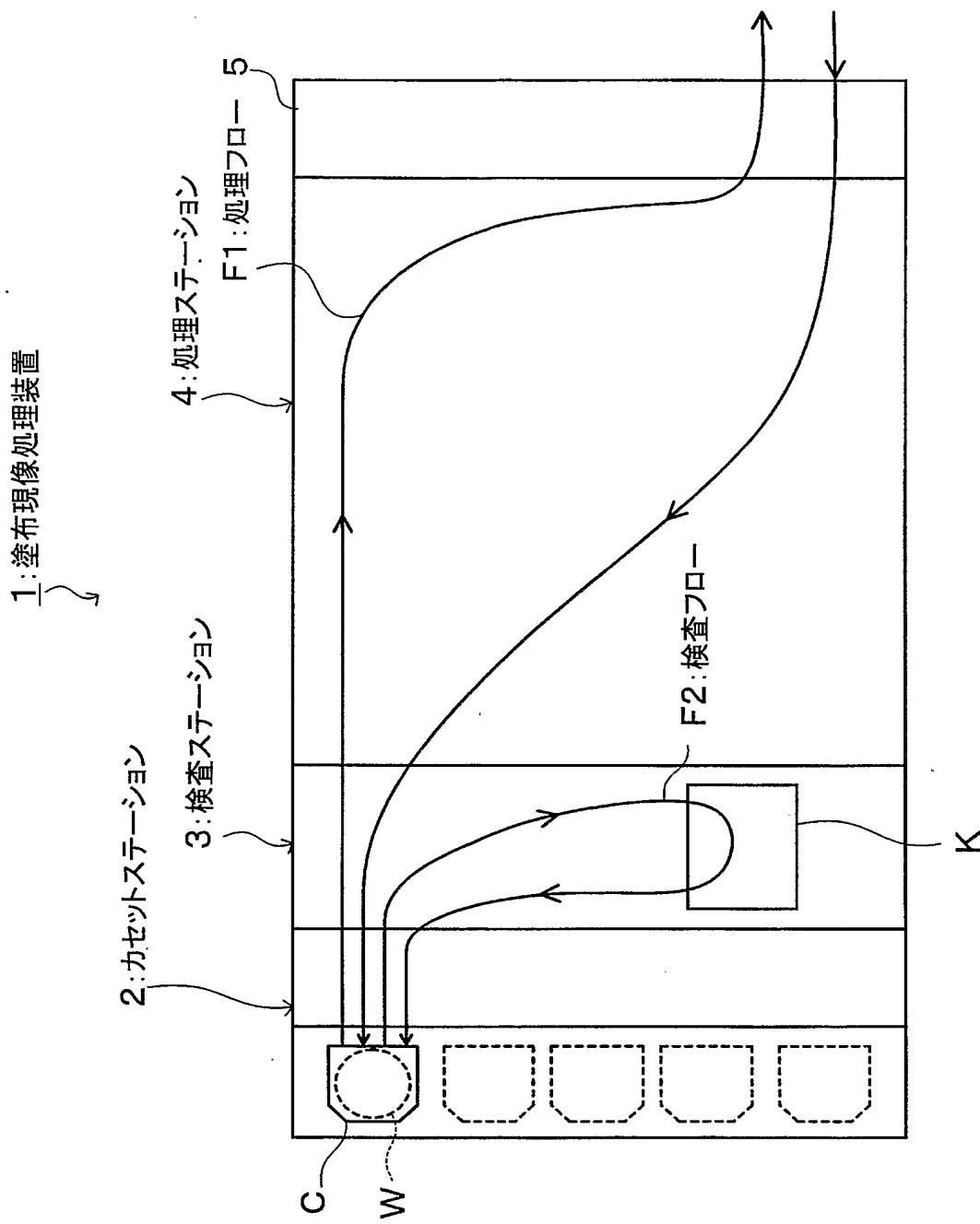
【図2】



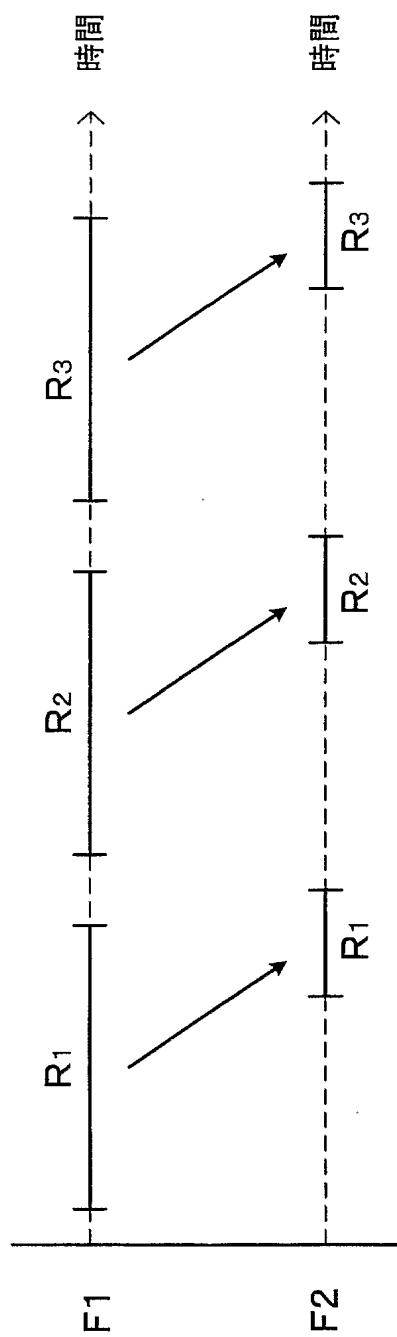
【図3】



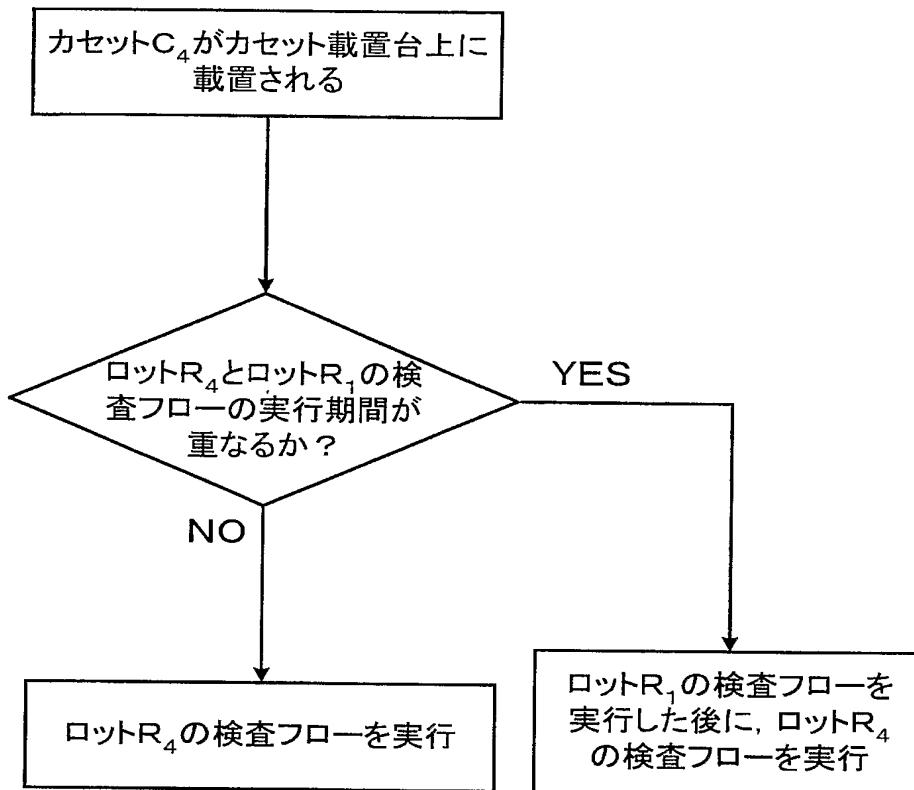
【図4】



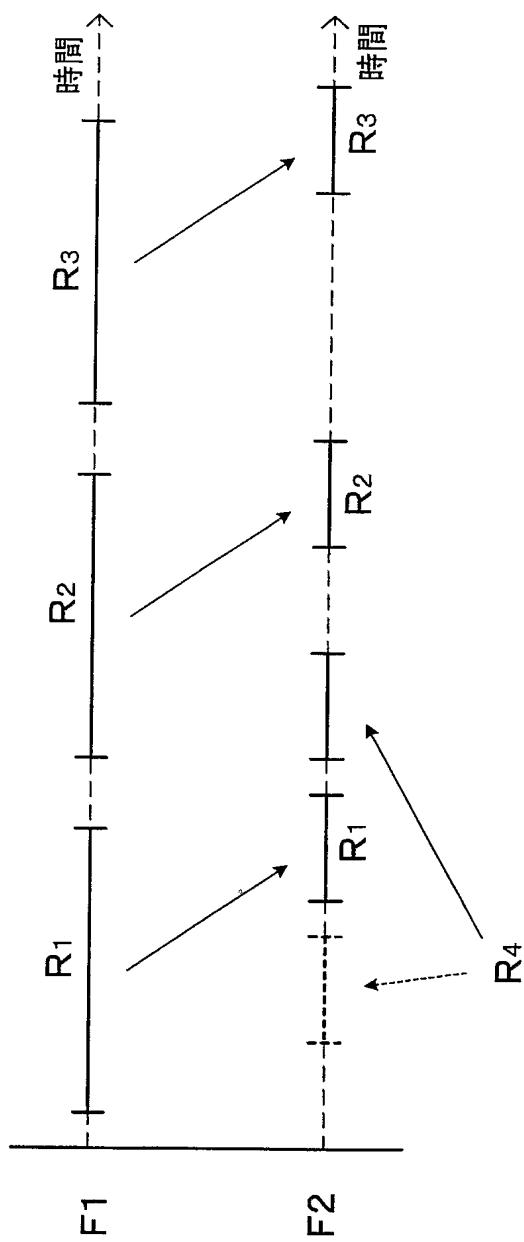
【図5】



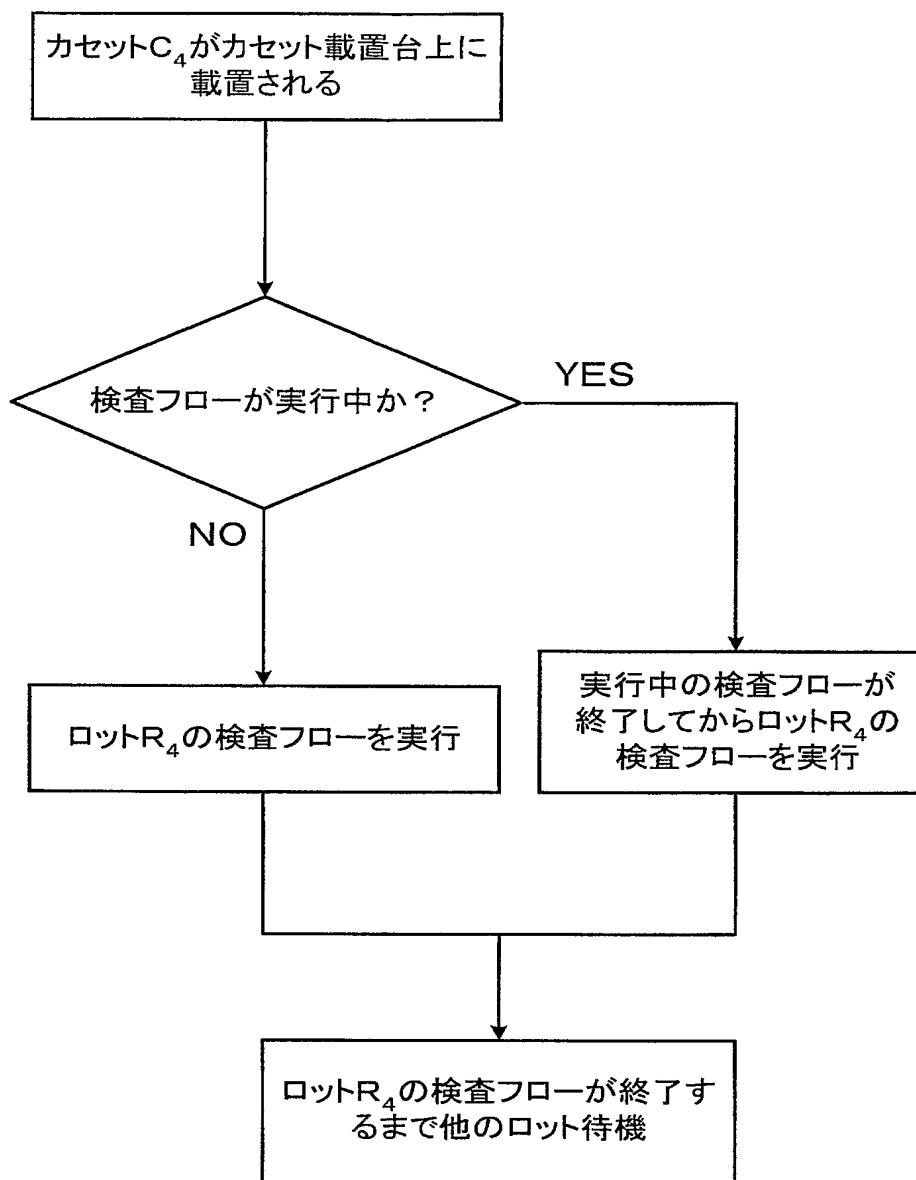
【図 6】



【図 7】



【図8】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 検査部を備えた塗布現像処理装置において、立ち上げ時に要する時間を短縮しコストを低減し、さらに検査部の稼働率を向上する。

【解決手段】 塗布現像処理装置1の制御プログラムにおいて、ウェハWをカセットステーション2から処理ステーション4に搬送して処理ステーション4及び露光装置でいて処理し、その後カセットステーション2に戻す処理フローF<sub>1</sub>と、ウェハWをカセットステーション2から検査ステーション3に搬送して検査し、その後カセットステーション2に戻す検査フローF<sub>2</sub>とを独立して実行できるように設定する。立ち上げ時に、検査フローF<sub>2</sub>と処理フローF<sub>1</sub>を実行し、同時期に検査ステーション3の検査ユニットの評価作業と処理ステーション4の処理ユニットの調整作業を行うことができる。検査ステーション3が空の時に外部からカセットステーション2にウェハWを搬入し検査を行うことができる。

【選択図】 図4

特願 2003-410105

## 出願人履歴情報

識別番号 [000219967]

1. 変更年月日 2003年 4月 2日

[変更理由] 住所変更

住所 東京都港区赤坂五丁目3番6号  
氏名 東京エレクトロン株式会社